

2005年中国半导体产业研究报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2005年中国半导体产业研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析

。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/2809028090.html>

报告价格：电子版: 11000元 纸介版：12000元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

根据中国半导体协会的数据，到2004年年底，中国国内有近50家晶圆制造厂，102家IC封测和IC装配厂，457家IC设计公司。2004年中国国内半导体业产值为364亿元人民币，大约为44亿美元，其中封测占了50%以上，晶圆制造占30%，IC设计不到20%。中国国内半导体市场的规模在2004年超过300亿美元。其中前20大厂家就有225亿美元。封测产业是中国半导体产业的核心部分，中国内地的封测企业都是为国外公司服务的。内地半导体市场前20大供应商大部分都在内地建立了的封测基地，要么是独资建立，要么是和海外的封测伙伴联合建立。国内最大的封测厂家其客户也主要是国外客户。严格的中资封测企业屈指可数。这9家公司的年产能折合8英寸晶圆达到180万片，而国内IC设计公司对晶圆的年需求不到50万片。因此这些晶圆厂必须寻求海外订单。

这些小的生产线大部分处于停产或者半停产状态，或者一开始就是实验线。中国的晶圆厂分四大类型，第一大为海外华人投资，依托政府支持和资本操作来获得资金来源，技术人才大多是挖角，来自台积电、联电和世界先进。以中芯国际为代表。其次是中外合资形式，华虹和NEC合资成立华虹NEC，先进半导体有飞利浦的投资。投资大多来自当地银行贷款，一般都主要为合资的外资方服务。再有就是台湾厂家改头换面或直接来投资，如和舰科技就是联电。一旦政策开放，南亚、茂德、力晶都会来中国内地投资。再有就是国内投资，这些国内投资资金主要来自银行贷款，很多是非理性上马的项目。产能利用率非常低，或者因为技术缺乏，长期无法投产。中国晶圆市场已经饱和，增长速率在2005年以后大幅度放缓，但是受到优惠政策的刺激，晶圆厂依然大量涌现，在建的晶圆厂多达19个，其中蕴涵着巨量泡沫。

正文目录第一章 中国半导体市场第二章 晶圆制造产业简介2.1 晶圆制造工艺简介2.2 全球晶圆产业及主要厂商简介2.3 中国半导体产业政策环境2.4 中国晶圆制造业现状及预测第三章 封测产业简介 3.1 封测工艺简介及未来发展趋势 3.2 全球IC封测市场简介 3.3全球IC封测产业格局 3.4 中国IC封测产业发展历史及现状 3.5 中国IC封测产业格局 3.6 中国IC封测产业预测 3.7 中国二手半导体设备市场现状 3.8 二手IC设备制造商格局 3.9 二手IC设备进口相关政策 第四章 半导体设备厂商 4.1 Applied Materials 4.2 Tokyo Electron Limited 4.3 ASML 4.4 KLA-Tencor 4.5 尼康精机公司 4.6 Dainippon Screen 4.7 Novellus 4.8 Lam Research 第五章 晶圆厂商 5.1 中芯国际 5.2 上海华虹NEC电子有限公司 5.3 上海宏力半导体制造有限公司 5.4 华润微电子 5.5 上海先进半导体 5.6 和舰科技（苏州）有限公司 5.7 BCD半导体制造有限公司 5.8 方正微电子有限公司 5.9 中宁微电子有限公司 5.10 南通绿山集成电路有限公司 5.11纳科（常州）微电子有限公司 5.12 珠海南科集成电子有限公司 5.13 康福超能半导体（北京）有限公司 5.14 科希-硅技半导体技术第一有限公司 5.15 光电子(大连)有限公司 5.16 西安西岳电子技术有限公司 5.17 吉林华微电子股份有限公司 5.18 丹东安顺微电子有限公司 5.19 敦南科技 5.20 福建福顺微电子 5.21 杭州立昂 5.22

杭州士兰微电子	5.23	宁波中纬	5.24	绍兴华越微电子	5.25	深爱半导体 (sisemi)	5.26
赛米微尔 (Semeware)	5.27	茂德科技	5.28	南京高新	5.29	上海汉升科集成电路	第六章
封测厂商	6.1	日月光	6.2	矽品	6.3	菱生精密	6.4
京元电	6.5	超丰电子	6.6	宁波明昕电子	6.7	宏盛科技	6.8
威宇科技GAPT	6.9	巨丰电子	6.10	通用半导体	6.11	瀚霖电子	6.12
捷敏电子	6.13	凯虹电子	6.14	桐芯科技	6.15	南茂	。。。。。。。。6.40
骊山微电子	6.41	汕头华汕电子器件有限公司	6.42	华联电子有限公司	6.43	上海华旭微电子	6.44
无锡华润安盛科技有限公司	6.45	中电华威电子 (原连云港华威电子)	6.46	江苏长电科技股份有限公司	6.47	邗江九星电子有限公司	6.48
玉祁红光电子	6.49	桂林斯壮微电子有限责任公司 (南方电子有限公司)	6.49	清溪矽德电子厂	6.50	珠海南科电子有限公司	部分图表目录
图1-1	中国半导体市场各类型IC所占比例统计	图2-1	原始晶圆的加工流程图	图2-2	晶圆植入电路的流程图	图2-3	台积电的全球主要客户
图2-4	联电主要客户	图2-5	新加坡特许半导体主要客户	图2-6	中芯国际主要客户	图2-7	2003-2009年中国晶圆代工厂销售收入统计与预测
图3-1	封测技术发展路线图	图3-2	全球IC封测市场统计与预测	图3-3	全球封测市场外包比例统计	图3-4	全球各类型封测出货量统计及预测
图3-5	FC与线邦定成本对比未来预测	图3-6	全球前4大封测厂家毛利润、净利润对比	图3-7	我国内地封装测试芯片数量及预测	图3-8	2003-2007我国内地封装技术及预测
图4-1	Applied Materials公司2004年4季度-2005年3季度收入统计及预测	图4-2	Applied Materials公司2004年4季度-2005年3季度净收入统计及预测	图4-3	Applied Materials公司收入地域分布图	图4-4	Tokyo Electron Limited2005财年收入比例一览
图4-5	Tokyo Electron Limited公司2001-2005年销售额统计	图4-6	Tokyo Electron Limited公司2001-2005年利润统计	图4-7	Tokyo Electron Limited公司2001-2005年员工数量统计	图4-8	Tokyo Electron Limited公司2005财年各地域所占收入比例统计
图4-9	ASML历年市场占有率统计	图4-10	ASML公司2000-2005年2季度收入统计	图4-11	ASML公司产品结构	图4-12	ASML公司按技术分产品结构
图4-13	ASML公司2005年2季度各地区收入统计	图4-14	ASML公司客户分布	图4-15	ASML公司2004年4季度-2005年2季度订单额与出货量及出货类型统计	图4-16	KLA-Tencor公司1999-2005年收入统计及预测
图4-17	2000-2005年尼康精机占整个尼康集团的收入比例	图4-18	尼康精机1981-2005年半导体设备出货量 (台)	图4-19	尼康精机1997-2005年按地域收入统计	图4-20	尼康精机1997-2005年收入按产品技术类型统计
图4-21	2005财政年度Dainippon Screen公司的收入比例结构	图4-22	2005财政年度Dainippon Screen公司的收入地区结构	图4-23	Dainippon Screen公司2003-2005年半导体设备部门的收入统计与预测	图4-24	

Dainippon Screen公司2003-2005年半导体设备部门各国家及地区收入比例	图4-25
Novellus公司2001-2004年销售额统计	图4-26
Novellus公司2001-2004年利润统计	图4-27
Novellus公司2001-2004年平均每个员工的销售额统计	图4-28
Advantest公司2001年1季度-2005年2季度订单额统计	图4-29
Advantest公司2001年1季度-2005年2季度销售额统计	图4-30
Advantest公司2003年-2005年2季度半导体设备部门销售额统计	图4-31
Advantest公司2003年-2005年2季度地区销售比例统计	图5-1
中芯国际2005年Q1各厂产能	图5-2
中芯国际2004年Q1 - 2005年Q1各区域销售比例	图5-3
2002 - 2004年前四大foundry市占率对比	图5-4
台积电、联电和中芯国际产能分析	图5-5
台积电、联电和中芯国际制程分析	图5-6
中芯国际晶圆厂年使用率	图5-7
中芯国际2003年Q3 - 2005年Q1营收与毛利率	图5-8
上海华虹NEC技术升级计划	图5-9
MLM工艺	图5-10
宏力半导体逻辑类技术的发展规划	图5-11
宏力半导体闪存类技术的发展规划	图5-12
宏力的CIM(计算机集成制造)系统	图5-14
宏力服务流程	图5-14
BCD产品分类	图5-15
BCD系列产品	图5-16
BCD系列产品	图5-17
BCD系列产品	图5-18
BCD系列产品	图5-19
1998-2002年光电子销售额和净利润统计	图5-20
2002-2005年1季度华微电子营业收入与毛利率统计	图5-21
2002-2004年华微电子营业收入按地区分布统计	图5-22
中纬工艺路线	图6-1
2000-2004财年日月光集团业绩(含子公司)	图6-2
2000-2004财年日月光半导体制造公司业绩	图6-3
2004财年日月光半导体销售收入地域分布	图6-4
日月光半导体市场占有率变化图	图6-5
2004Q1-2005Q2日月光集团(含子公司)业绩	图6-6
2004Q1-2005Q2日月光集团(含子公司)IC封装部门业绩	图6-7
2004Q1-2005Q2日月光集团(含子公司)IC封装收入组成	图6-8
2004Q1-2005Q2日月光集团(含子公司)测试部门业绩	图6-9
2004Q1-2005Q2日月光集团(含子公司)测试部门组成	图6-10
2005Q1和Q2日月光集团收入行业分布	图6-11
矽品科技封装技术演化图	图6-12
2000-2005Q2矽品科技销售业绩	图6-13
2002-2004财年矽品科技销售收入组成	图6-14
2002-2004财年矽品科技销售收入地域分布	图6-15
2000-2004年矽品科技市场占有率变化图	图6-16
2000-2004财年菱生精密销售业绩	图6-17
2004财年菱生精密销售收入地域分布	图6-18
2004Q1-2005Q2菱生精密销售业绩	图6-19
2004Q1-2005Q1京元电销售业绩	图6-20
2000-2004财年京元电销售业绩	图6-21
2002-2004财年超丰电子销售业绩	图6-22
2000-2004财年上海宏盛科技业绩	图6-23
2004财年上海宏盛科技销售收入主要产品来源	图6-24
2000-2004财年南茂科技业绩	图6-25
2002-2004财年南茂科技销售收入组成	图6-26
2004财年南茂销售收入地域分布	图6-27
2004年前10大封装测试公司	图6-28
安可1990-2004年营收状况	图6-29
安可科技2001-2005年按季度营收	图6-30
Amkor在全球的市场占有率	图6-31
新科金朋合并前后封装的产品领域分析	图6-32

新科金朋合并前后封装测试所占比例情况	图6-33
新科金朋2004年3季度-2005年2季度财务情况	图6-34
联合科技2004-2005年2季度分季营收状况	图6-35
联合科技2004年产品分类营收	图6-36
联合科技2004年封装及测试所占营收比例	图6-37
联合科技2004年产品按应用领域的营收	图6-38
联合科技2004年产品按地区营收状况	图6-39
2003-2005年天水华天科技公司销售收入	图6-40
2002-2005Q1江苏长电公司主营业务收入及净利润率变化情况	图6-41
IC产量情况	
产量(百万只)	图6-42
DISCRETE DEVICE 产量情况	图6-43
产量(百万只)	图6-44
97-03年江苏长电销售收入(万元)	图6-44
江苏长电股份有限公司人员构成	表1-1
中国主要消费类电子产品产量统计	表1-2
2004年中国内地半导体市场前20大供应商	表1-3
半导体各领域主要厂商	表2-1
2004年全球前20大纯晶圆代工厂收入及增幅统计	表2-2
台积电自99年1季度到2005年2季度平均价格图	表2-3
中国已经投产的主要6、8、12英寸晶圆厂简介一览	表2-4
中国在建的6、8、12英寸晶圆厂简介一览	表2-5
中国4、5、6英寸晶圆厂名单	表2-6
中国前6大晶圆厂2004年收入一览	表3-1
封测产业术语表	表3-2
2004年全球10大封测厂家	表4-1
2004年半导体设备10大供应商排名	表5-1
中芯国际主要晶圆代工厂情况	表5-2
中芯国际技术文件的支持	表5-3
中芯国际提供的IP	表5-4
中芯国际现有的单元库	表5-5
0.35 μm 5V 工艺 (CZ6H)概况一览	表5-6
0.35 μm 5V的嵌入式EEPROM	
工艺(CZ6HFT)概况一览	表5-7
0.35 μm 3.3V 工艺(UC1)概况一览	表5-8
宏力主要产品的设计规则	表5-9
宏力0.25微米工艺技术主要特性	表5-10
0.25微米器件的电性设计参数	表5-11
宏力0.15微米技术的主要工艺参数	表5-12
0.15微米器件的电性设计参数(EDR)	表5-13
宏力的电子商务体系功能	表5-15
华润微电子产品类型	表5-16
BCD产能一览	表5-17
中纬服务流程	表6-1
2004年日月光主营业务销售收入商品种类列表	表6-2
矽品科技测试技术	表6-3
菱生精密封装类型	表6-4
菱生精密的测试服务	表6-5
超丰电子封装能力	表6-6
超丰电子测试能力	表6-7
台湾华昕目前的封装能力	表6-8
2004财年宁波明昕微电子股份有限公司业绩	表6-9
吴江巨丰电子测试能力列表	表6-10
Intel测封厂一览	表6-11
英特尔产品(上海)有限公司概况一览	表6-12
摩托罗拉(天津)测封厂概况一览	表6-13
飞利浦半导体(广东)有限公司概况一览	表6-14
飞利浦半导体(苏州)有限公司概况一览	表6-15
国家半导体(苏州)有限公司中国内地客户	表6-16
国家半导体(苏州)有限公司概况一览	表6-17
AMD在华企业概况一览	表6-18
安可全球客户一览	表6-19
Amkor在全球封测行业的排名	表6-20
安可封装测试(上海)有限公司概况一览	表6-21
新科金朋全球分领域客户表	表6-22
2004年合并前的主要客户情况	表6-23
新科金朋与全球主要晶圆代工厂的合作关系	表6-24
新科金朋(上海)有限公司概况一览	表6-25
三星电子(苏州)半导体有限公司概况一览	

表6-26 无锡开益禧半导体有限公司 表6-27 中山开益禧半导体有限公司概况一览 表6-28 新加坡联合科技主要客户 表6-29 联合科技(上海)有限公司 表6-30 ASAT公司主要客户 表6-31 ASAT主要封装形式 表6-32 上海松下半导体主要封装形式 表6-33 上海纪元微科微电子主要封装形式 表6-34 瑞萨半导体(苏州)有限公司主要封装形式 表6-35 矽格电子的主要封装形式 表6-36 南通富士通主要封装形式 表6-37 南通富士通封装系列产品 表6-38 瑞萨四通主要封装形式 表6-39 天水华天主要封装形式 表6-40 安盛科技主要封装形式

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/2809028090.html>